

上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过41,668,198股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月5日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2020年7月10日获中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1439号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售B股股份的持有市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为41,668,198股,初始战略配售数量为6,250,228股,占本次发行数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量1,468,626股,占本次发行数量的3.52%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,781,602股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为33,116,070股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.38%;网上初始发行数量为7,083,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.62%。最终网下、网上发行合计数量40,199,570股。

网上网下回拨机制启动后,网下回拨至网下发行,网下发行数量最终为33,116,070股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.38%;网上回拨至网下发行,网上发行数量最终为7,083,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.62%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03509634%。

网下发行价格为人民币133.45元/股。

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为4.46632倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即4,020,000股)从网下回拨到网上,回拨机制启动后,网上最终发行数量为29,096,070股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.38%;网上最终发行数量为11,103,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.62%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03509634%。

网下配售投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月5日(T+2日)及时履行缴款义务。

网下配售投资者应根据本公告及时足额缴纳新增认购资金和相应的新股配售资金(四舍五入精确至分)。网下配售投资者在缴纳新增认购资金时需一并划付对应的新股配售佣金,资金应于2020年8月5日(T+2)16:00前到账,网下投资者需同日汇一笔多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,由此产生的

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

杭州华光焊接新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“华光新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年5月26日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并于2020年7月22日获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2020)1533号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售B股股份的持有市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票1,100万股,占发行后公司总股本的25.00%,初始战略配售发行数量为110万股,占本次发行总量的5.00%,最终网下、网上发行合计数量为990万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,463万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为627万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网

上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2020年8月6日(T-1) 09:00-12:00
2. 网上路演网址:
上证路演中心: <http://roadshow.seinfo.com>
中国证劵网: <http://roadshow.cnstock.com>

3. 参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:杭州华光焊接新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

2020年8月5日

安克创新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

安克创新科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月16日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可(2020)1592号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市非限售A股股份和非限售B股股份的持有市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股4,100万股,占发行后发行人总股本的10.09%。

本次发行初始战略配售数量为615万股,占本次发行数量的15.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购本次发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为公募产品)符合创业板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的专项资产管理计划、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金报价中位

成都大宏立机器股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会同意注册(证监许可(2020)1578号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市非限售A股股份和非限售B股股份的持有市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行不安排向其他外部投资者定向配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公开募集方式设立的专项资产管理计划、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

本次发行初始战略配售数量为2,392万股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公开募集、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为119.60万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售数量与初始配售

芯原微电子(上海)股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司

联席主承销商:海通证券股份有限公司

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年5月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可(2020)1537号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售B股股份的持有市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、保荐机构(联席主承销商)及联席主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、(招商证券与海通证券并称为“联席主承销商”)负责组织实施。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股4,831,928万股,占发行后总股本的10.00%。

本次发行初始战略配售数量为724,783万股,占本次发行数量的15.00%。其中,本次保荐机构相关子公司的预计跟投比例为本次发行股份数量的5.00%,即241,596.5万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司

联席主承销商:海通证券股份有限公司

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于豁免关联交易审议的进展公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

北京昭衍新药研究中心股份有限公司